

東京電子材料株式会社（日本）



東京電子材料株式会社のソルダーマスキング剤マスクアクトはプリント配線板の後付け部品の実装箇所、プリント配線板の半田レベラー時の端子部などをマスキングする為に開発されたペースト状の

マスキング剤です。塗布方法、硬化方法、除去方法によりいくつかの組み合わせが出来ますので、用途に合わせて最適なマスキング剤をご選択下さい。

従来のマスキングテープと比べ、ディスペンサー塗布、スクリーン印刷が可能であり、短期間に大量の基板をマスクする事が出来、剥離又は洗浄後、残渣が残らないという特長があり、省力化に大きく寄与致します。

TECHNICAL DATA REPORT（ソルダーマスキング剤）

分類

	製品名	塗布方法			硬化方法		除去方法			主な用途		
		手塗	ディスペンサー	スクリーン印刷	自然乾燥	加熱硬化	剥離	水洗浄	有機溶剤洗浄	後付部品部	金メッキ部	金メッキはんだメッキ
I	マスクアクト TC-530	○	○		○	○	○			○		
	マスクアクト TC-533	○	○		○	○	○			○		
II	マスクアクト VC-582		○	○		○	○			○	○	○
	マスクアクト VC-583			○		○	○			○	○	○
	マスクアクト VC-587		○	○		○	○			○	○	
III	マスクアクト AQ-567-D	○	○		○	○		○		○		